2023-05-04

SK 증권

Analyst 박형우 · 3773-9035 · hyungwou@sks.co.kr

Issue Comment

✓ 주가하락 배경: 일부기업 실적 쇼크 및 퀄컴 컨콜

✓ 패키징기판 산업 동향: 반등은 예상 대비 느리고 완만함

✓ 그러나 패키징기판 업황은 저점을 통과

금일 기판(부품)주 주가 하락 관련 코멘트

▶ 금일 장중 기판군 주가 하락세 (오후 1 시 5 분 기준)

- 심텍 -7%, 대덕전자 -8%, 이수페타시스 -6%, 비에이치 -7%, 해성디에스 -3%, 티엘비 -2% 등

▶ 주가 하락 배경

- 전일, 반도체용 패키징기판 기업 기업인 심텍과 대덕전자의 실적 쇼크
- 심텍의 상반기 실적 전망치 하향 (Dart 공정 공시)

영업이익 전망 (3 개월 전 52 억원 → 현재 -557 억원)

- 퀄컴의 실적발표 코멘트 : “중국 모바일 부품주문 약세”

▶ 애널리스트 코멘트

- 현재의 기판 주문 부진은 IT 수요 약세, 페널티, 점유율 변화 영향
- 패키징기판 반등 흐름, 당초 예상보다 느리고 완만함

(한달 전보다 현재 눈높이 낮아짐)

- 그러나 반도체용 기판 업황은 이미 저점을 통과:

후공정과 기판 업체들 가동률은 이미 크게 낮아짐 (= 기판 재고조정)

▶ 투자의견

- 기판의 투자포인트는 반등의 강도가 아닌 ‘바닥의 시점’
- 전일 기업들의 실적 쇼크를 고려하면 현재의 주가하락은 타당. 그러나 저점에 대한 고민 지속 필요
- 신뢰할 수 있는 기업 or DDR5 비중 높은 기업 주목 (MCP, FCCSP, SiP, FCBGA 등은 DDR5 아님)

▪ 작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
▪ 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
▪ 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
▪ 투자판단 3 단계 (6 개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도